

# パワーモジュール実装信頼性に対する封止樹脂物性の影響

(株) 先端力学シミュレーション研究所 伊勢谷健司

封止樹脂のヤング率及び線膨張係数をパラメータとして、パワーモジュール実装信頼性に対する感度解析を実施し、損傷パラメータ予測式を作成した。物性の異なる封止樹脂をそれぞれ使用した場合のパワーサイクル試験を実施した結果、損傷パラメータ予測式から予測される順位と実際の寿命サイクル数の順位は良く一致した。